

kit per reballing bga i phone e telefoni cellulari (10 EUR)



Luogo **Campania, Portici**
<https://www.annunci.it/x-44411-z>



KIT BAKU BK-7015 TORX STRUMENTI SALDATURA per NOKIA MOTOROLA BLACKBERRY SAMSUNG

Descrizione prodotto
Kit utile per la rimozione e sostituzione di chip nel campo della telefonia cellulare i-phone smart phone ecc. il kit comprende le mascherine in metallo forellate per il posizionamento delle sferette in stagno per la risaldatura

- 01. Supporto per lo svolgimento di PCB PCB board. Dimensioni: 220 * 155 * 2mm
- 02. La distribuzione dei fori di fissaggio appositamente utilizzando per inserire le viti per 4GS Iphone e con le dimensioni di 1,2 millimetri e 0,8 millimetri + pentagono cacciaviti.
- 03. Apertura di strumenti per la rimozione dell'antenna e aprire l'involucro telefono. Dimensioni: 120 * 7.5 * 4 millimetri
- 04. Portable PLCC Strumento clip IC Extraction Extractor per estrarre la fotocamera dei telefoni.

- 05. Cacciaviti con il size of T5 T6 per BlackBerry
- 06. Saldatura per la saldatura
- 07. Apertura di strumenti per la apertura del telefono di Nokia e Samsung

- 08. Pasta di saldatura per la saldatura
- 09. Rasatura coltello usando per la saldatura.
- 10. Ventosa utilizzando per estrarre il telefono cellulare LCD.



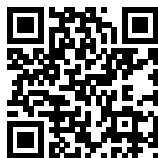
<https://www.annunci.it/x-44411-z>
kit per reballing bga i phone e telefoni cellulari



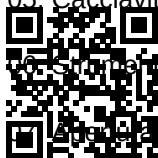
<https://www.annunci.it/x-44411-z>
kit per reballing bga i phone e telefoni cellulari



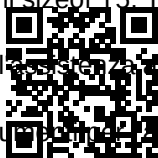
<https://www.annunci.it/x-44411-z>
kit per reballing bga i phone e telefoni cellulari



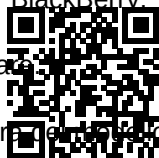
<https://www.annunci.it/x-44411-z>
kit per reballing bga i phone e telefoni cellulari



<https://www.annunci.it/x-44411-z>
kit per reballing bga i phone e telefoni cellulari



<https://www.annunci.it/x-44411-z>
kit per reballing bga i phone e telefoni cellulari



<https://www.annunci.it/x-44411-z>
kit per reballing bga i phone e telefoni cellulari



<https://www.annunci.it/x-44411-z>
kit per reballing bga i phone e telefoni cellulari



<https://www.annunci.it/x-44411-z>
kit per reballing bga i phone e telefoni cellulari



<https://www.annunci.it/x-44411-z>
kit per reballing bga i phone e telefoni cellulari

11. Apertura di strumenti che aiutano ad aprire l'involucro del telefono.

12. Dissaldante stoppino saturo di wash-free flux.Length RMA: 1,5 millimetri Larghezza: 1,5 mm

13. Piastra BGA ad alta temperatura, acido-resistenza,

Corrosione - resistenza, permeabilità.

10 euro Durata annuncio: 90

Tel: 3493425011